



Turbo Package Analyzer

2000年1月27~28日

EDA TechnoFair 2000

アンソフト・ジャパン株式会社



Turbo Package Analyzer

- ➡ **自動化された 3Dモデリングと、複雑なパッケージ全体の電気的特性抽出**
 - 電源/グランド バウンス解析
 - ボンディング ワイヤ、ソルダ ボール、トレース、誘電体、電源 /グランド 形状
- ➡ **複雑な形状、多ピン、シングルチップに最適化**
- ➡ **他のツールとのシームレスなインターフェイス**
 - Cadence's APD and Allegro
 - Xynetix Encore BGA
 - AutoCAD DXF file format



Turbo Package Analyzer

- ➡ パッケージ全体（全ピン）の寄生パラメタの抽出
- ➡ クロストーク解析の為の複数導体モデルの生成
 - ユーザーは、取り込む近隣のネットの本数を選択出来る。
 - 自動的に全ての電源/グランド形状（正確な形状）が3Dモデルに取り込まれる。
- ➡ **Outputs（各トレースに対して自動的に生成）：**
 - 導体相互のカップリングを含んだ集中定数モデル（3D parasitic models）
 - カップリングを含んだ PEEC等価回路
 - SPICE
 - Cadence DML file format



Solid Model Example

